

CS1

다공성 그물구조 음극을 이용한 구리 전착

I. 전해질 중의 구리 이온 농도의 영향

Electrodeposition of copper on retic ular structure cathode

I. Effect of cupric ion concentration

이관희, 이화영, 정원용

한국과학기술연구원 금속공정연구센터

<연구목적>

그물구조 다공성 금속은 일반적인 고상(固狀)재료와는 달리 구조적인 특수성과 거기서 비롯된 고유의 물리적 성질로 인해 많은 기능을 가지고 있다. 본 연구에서는 그물구조 다공성 구리를 전기화학적인 방법을 이용하여 제조하였으며, 황산동과 황산을 사용한 산성 전해질을 이용하여 전착하였다. 이 때 나타나는 균일전류밀도분포력(throwing power)을 향상시켜 균질한 그물구조 다공성 금속을 제조하는데 영향을 미치는 구리 이온의 농도와 그 전기화학적인 거동을 고찰하였다.

<실험방법>

여러 가지 전해질 조건에 따른 구리전극의 음극 분극을 통하여 2차전류밀도분포를 예측하고, 그 형상과 실제 전착되는 구리의 양적 분포를 Hull cell 실험을 통하여 확인하였다. 이러한 실험을 통해 얻어진 전해질 조건에서 구리판을 양극으로 사용하고, 그물구조 다공성 전극을 음극으로 사용하여 전착실험을 실시하였다. 이 때 음극의 내부와 외부의 구리 분포를 확인함으로써 균일전류밀도분포력(throwing power)의 향상과 실제 구리 이온의 균질 전착에 대하여 고찰하였다.

<연구결과 및 고찰>

전해질 중의 황산에 대한 구리 이온의 농도비가 감소하면 황산염의 해리가 촉진되고 전해질의 점성이 감소하여 전기전도도의 향상을 가지고 오며 음극 분극을 촉진시켜 균일전류밀도분포력(throwing power)을 향상시키는 효과를 나타내었다.